

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT

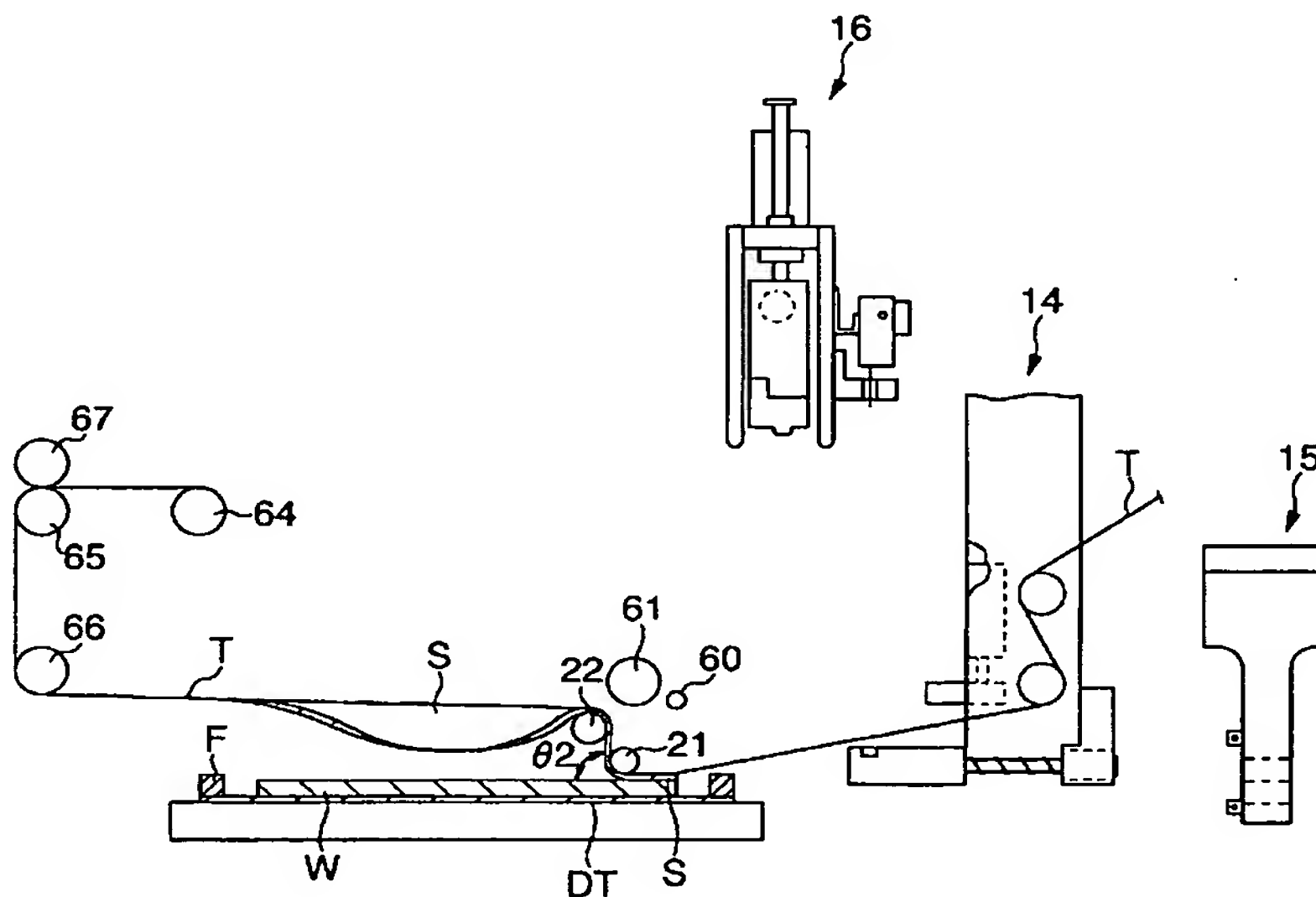
(10) 国際公開番号  
WO 2005/041282 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/304, 21/68  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015581  
(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願 2003-365859  
2003 年 10 月 27 日 (27.10.2003) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リン  
テック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP];  
〒1730001 東京都板橋区本町 2 3-2 3 Tokyo (JP).  
(72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 辻本正樹 (TSU-  
JIMOTO, Masaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本  
町 2 3-2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 吉岡  
孝久 (YOSHIOKA, Takahisa) [JP/JP]; 〒1730001 東京  
都板橋区本町 2 3-2 3 リンテック株式会社内 Tokyo  
(JP).  
(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034  
東京都多摩市鶴牧 1 丁目 4 番 1 7 号 いずみビル 8 F  
Tokyo (JP).  
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: SHEET-PEELING DEVICE AND METHOD

(54) 発明の名称: シート剥離装置及び剥離方法



(57) Abstract: A sheet-peeling device and a sheet-peeling method that enable a sheet to be peeled off in an optimum condition depending on the material, thickness, etc. of a protective sheet by appropriately using plural peeling means. A sheet-peeling device (10) peels off a sheet (S) adhered to a surface of a semiconductor wafer (W) by using an adhesive tape (T) having the width smaller than that of the sheet (S). The device has a peeling head section (15)(second peeling means) for peeling the sheet (S) off by pulling the sheet (S) in an obtuse angle direction with the tape (T) adhered to an end section of the sheet and has a first and second rollers (21, 22)(first peeling means) for peeling the sheet (S) off by pulling the sheet in a relatively moderate separation angle direction with the adhesive tape (T) adhered to the sheet (S) in the direction lateral to the sheet. Either of these peeling means is selectively used depending on the type of the sheet (S).

(57) 要約: 複数の剥離手段を使い分けて保護シートの材質や、肉厚等の相違に応じて最適な条件で剥離を行うことのできるシート剥離装置及び剥離方法を提供する。 半導体ウエハWの面に貼付されたシートSを、これより幅狭の接着テープTを用いて剥離するシート剥離装置

[続葉有]



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

10であり、当該装置は、接着テープTを前記シートの端部に接着した状態で鈍角方向に引っ張ってシートSを剥離する剥がしヘッド部15（第2の剥離手段）と、接着テープTをシートSを横断する方向に接着した状態で、相対的に緩やかな剥離角度方向に引っ張ってシートSを剥離する第1及び第2のローラ21, 22（第1の剥離手段）とを備えている。これら剥離手段は、シートSの種別に応じて何れか一方を選択して利用される。